

Item Description	Components and parts requiring selective treatments	Quantity of items included in product
	☐ other. Explain _____	
Mercury-containing components. For example, mercury in lamps, display backlights, scanner lamps, switches, batteries		0
Liquid Crystal Displays (LCD) with a surface greater than 100 sq cm. Includes background illuminated displays with gas discharge lamps	☒ Panel LCD	1
Cathode Ray Tubes (CRT)		0
Capacitors / condensers (Containing PCB/PCT)		0
Electrolytic Capacitors / Condensers measuring greater than 2.5 cm in diameter or height	☐ Power Supply capacitor(s) or condenser(s)	0
External electrical cables and cords	☒ AC power cord ☐ Audio, video or data cables ☐ Other: _____	1
Gas Discharge Lamps		0
Plastics containing Brominated Flame Retardants (not including external electrical cables and cords, PCBs or PCAs already listed as a separate item above)		0
Components and parts containing toner and ink, including liquids, semi-liquids (gel/paste) and toner. Include the cartridges, print heads, tubes, vent chambers, and service stations.		0
Components and waste containing asbestos		0
Components, parts and materials containing refractory ceramic fibers		0
Components, parts and materials containing radioactive substances		0
Components containing chlorofluorocarbons (CFC), hydrochlorofluorocarbons (HCFC) or hydrofluorocarbons (HFC), hydrocarbons (HC)		0

2.0 Tools Required

List the type and size of the tools that would typically be used to disassemble the product to a point where components and materials requiring selective treatment can be removed.

Tool Description	Tool Size (if applicable)
Screwdriver	Philip #0 #1
Screwdriver	Torx T8
Heatgun	N/A
Suction cup	N/A

3.0 Product Disassembly Process

3.1 List the basic steps that should typically be followed to remove components and materials requiring selective treatment including the required steps to remove the external enclosure.

1. Remove X
2. Remove Y
3. Remove Z

3.2 Location of components requiring selective treatment. The photos and/or graphics below identify the location of the parts or components requiring selective treatment within the main unit. For End-of-Life product disassembly instructions of external accessories including external power supply (EPS), external keyboard (KB) external mouse and external cables and cords, refer to the following URL: [End-of-Life Product Disassembly Instructions \(hp.com\)](#)

MANUFACTURING PROCESS INSTRUCTIONS

MECHANICAL ASSEMBLY

Sub-assembly name:	Disassembly SOP		
Written by:	Chen. Hailey	Revision:	1.00
Date:	2024/11/6	Page:	1 of 25

A. Current station version list:

Station	Version	Station	Version	Station	Version	Station	Version	Station	Version	Station	Version
1	1.00	11	1.00	21	1.00						
2	1.00	12	1.00	22	1.00						
3	1.00	13	1.00	23	1.00						
4	1.00	14	1.00	24	1.00						
5	1.00	15	1.00								
6	1.00	16	1.00								
7	1.00	17	1.00								
8	1.00	18	1.00								
9	1.00	19	1.00								
10	1.00	20	1.00								

B. Version Modify list:

[illegible]

审核：廖才勇 编制：昌勇

作业指导书

Sub-assembly name :
作 业 名 称 : Disassemble rear cover screws

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 1(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤：

-  1. Remove rear cover SET screws *4
-  Torque value: 1.5±0.2 kgf.cm
-  Do not scratch the back cover when removing the screws
-  Do not slip screws



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

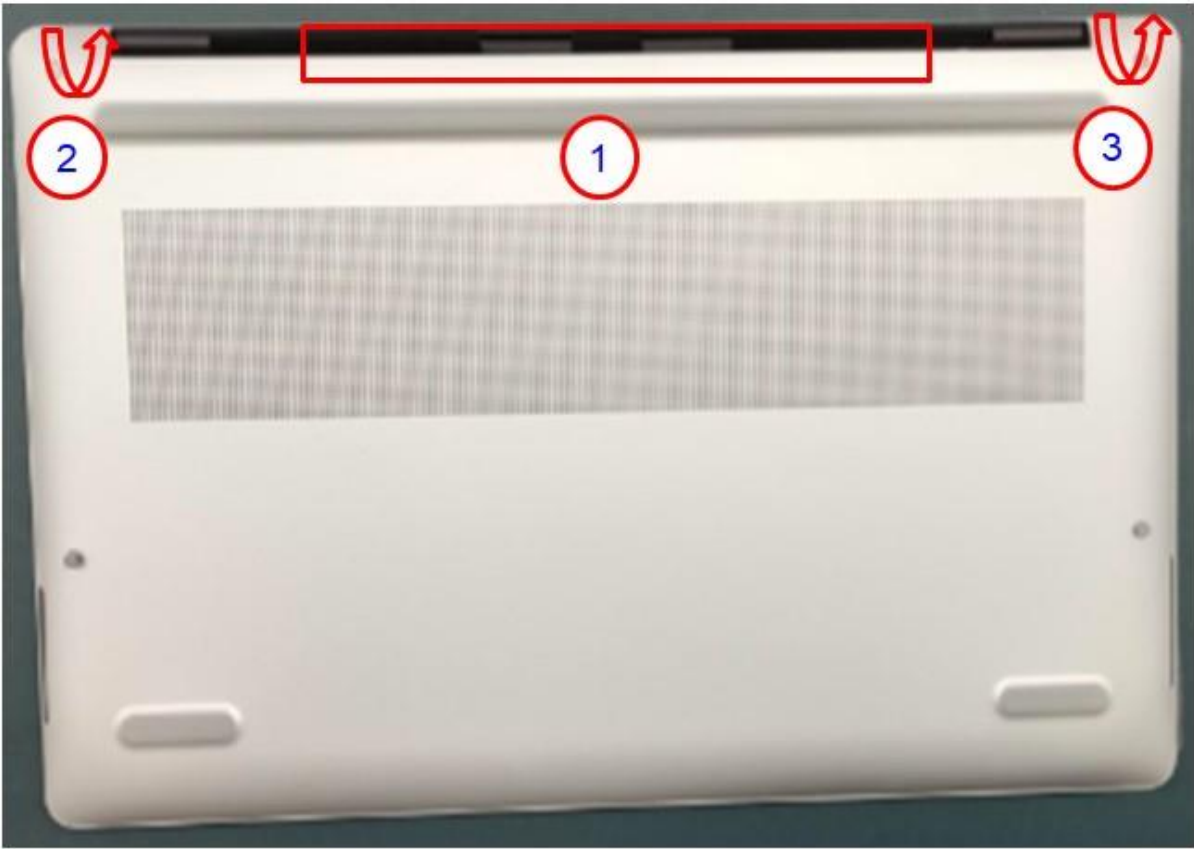
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble BASE

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别 : 2(1/1)
编辑日期 : 2024/11/06

步骤：

-  1. Separate Base with wire rod
Step: Insert the wire rod from the gap between TOP and BASE, then slide the wire rod to separate TOP from BASE
-  2. The hands are placed in the hinge of the base & top split, top down, base up.
-  3. Remove base from the machine.



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
拆机棒	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

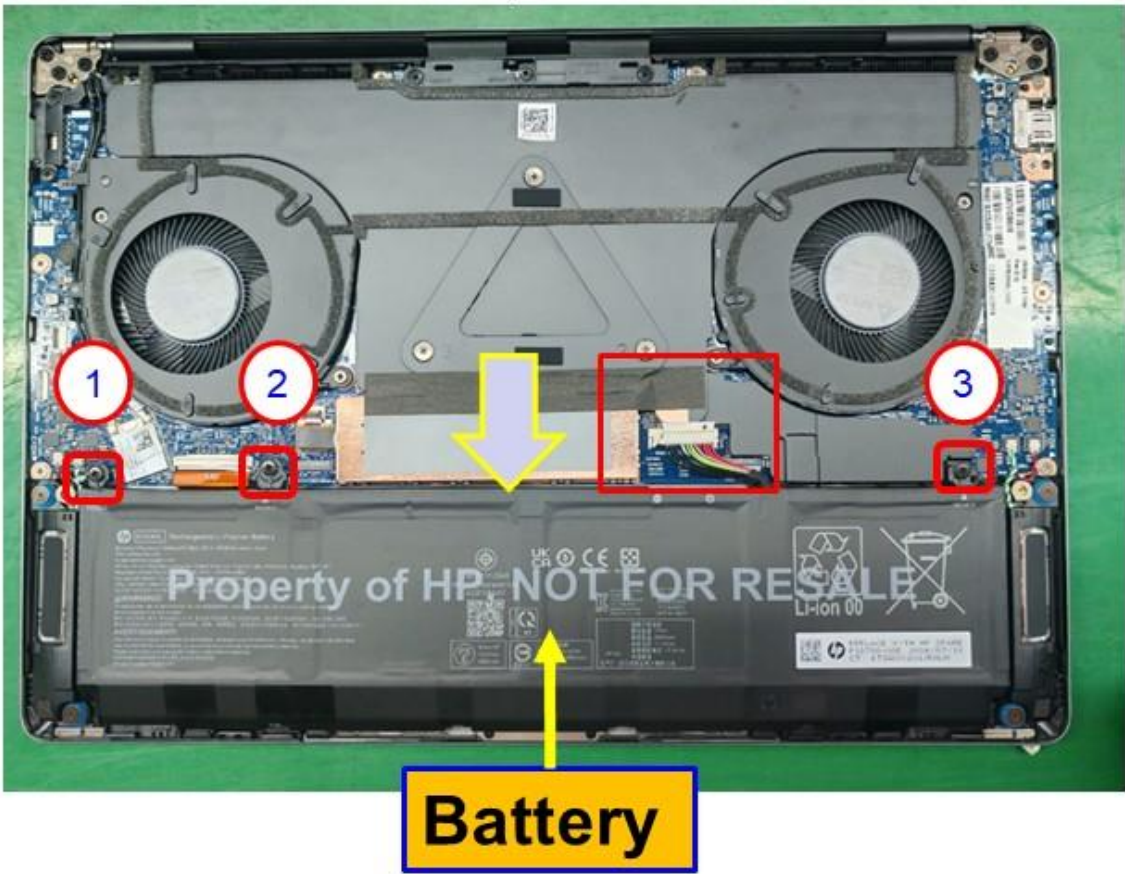
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble battery

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 3(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove the battery CNTR
-  2. Remove battery screws *3
◆ Torsion value: 1.5 ± 0.2kgf.cm
◆ Make sure the screws do not slip
-  3. Remove the battery



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

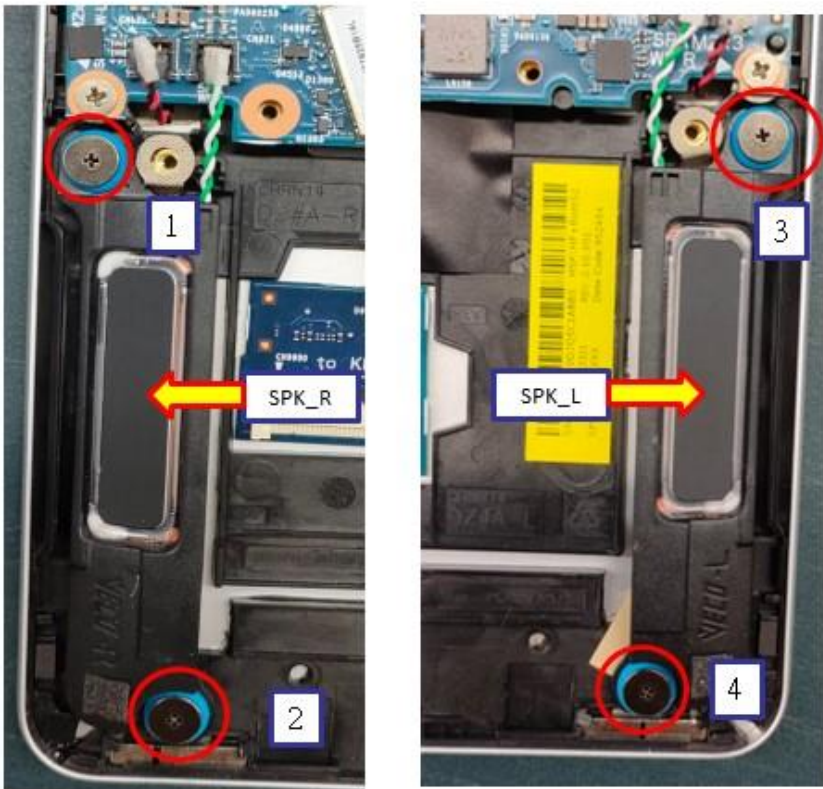
Sub-assembly name :
作业名称：Disassemble Speaker

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 4(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤：

- 1. Remove the speaker screws *4
◆ Torsion value: 1.5 ± 0.2kgf.cm
◆ Make sure the screws do not slip
- 2. Remove the speaker CNTR
- 3. Take out Speaker *2



图一

注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子#1	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble Shielding Can

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 5(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove the SSD shielding can after removing the Gasket



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
									
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

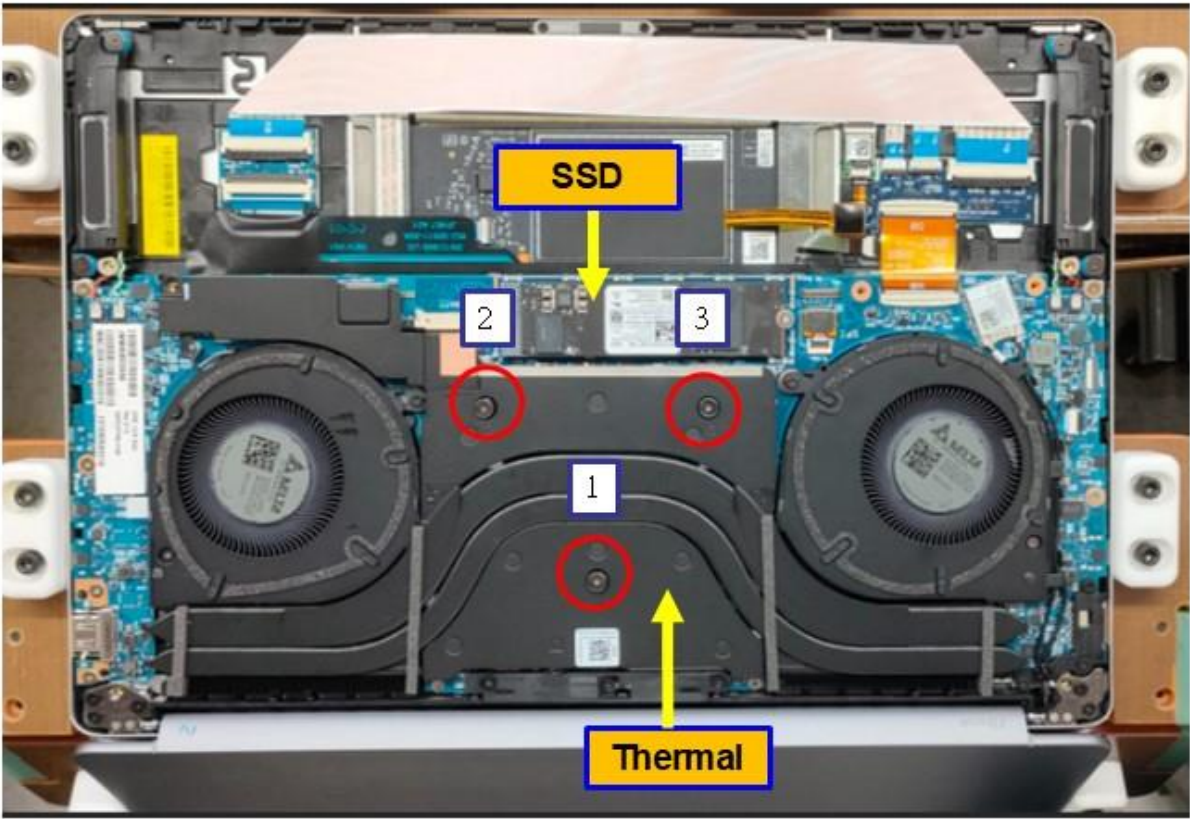
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble Thermal

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 6(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove the Thermal screws *3
◆ Torsion value: 1.5 ± 0.2kgf.cm
◆ Make sure the screws do not slip
-  2. Take out the Thermal



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子#1	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

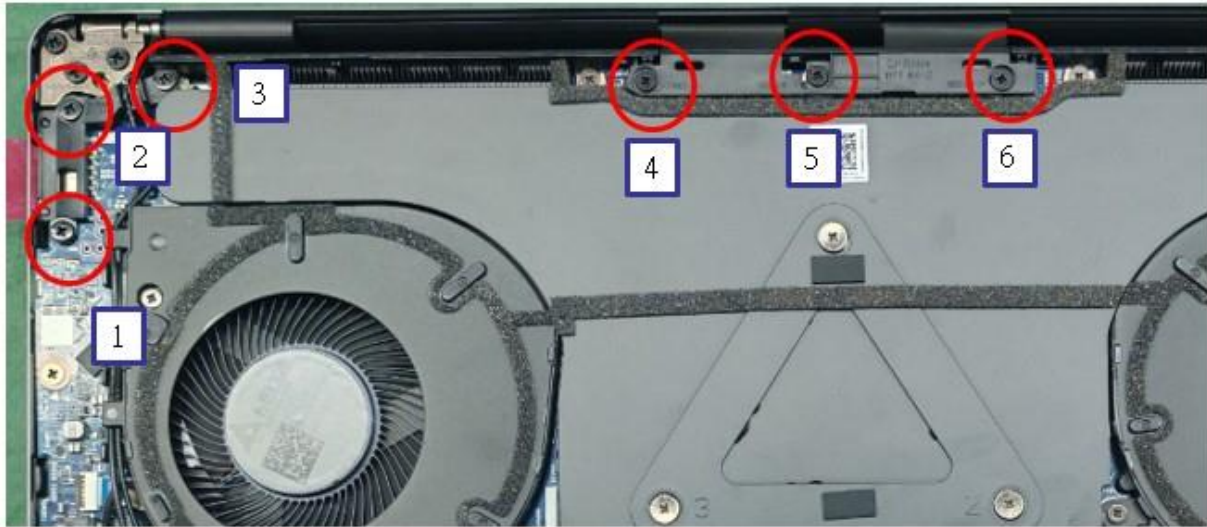
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble Holder

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 7(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

- 1. Remove the Holder screws *6
◆ Torsion value: 1.5 ± 0.2kgf.cm
◆ Make sure the screws do not slip
- 2. Take out the Holder*2



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子#1	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作 业 指 导 书

Sub-assembly name :
作 业 名 称 : Disassemble EDP & Camera FPC

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别 : 8(1/1)
编辑日期 : 2024/11/06

步骤：

1. Remove the antenna PC (Figure 1)
2. Remove the antenna terminal *2 and remove the antenna from the hook (Figure 2)
3. Disassemble EDP &Camera FPC (Figure 3)
◆ When disassembled vertically, the CNTR cannot be deformable



Figure 1

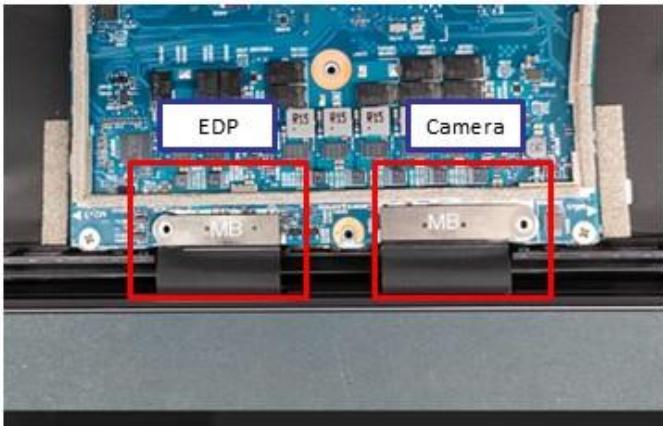


Figure 3



Figure 2

注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

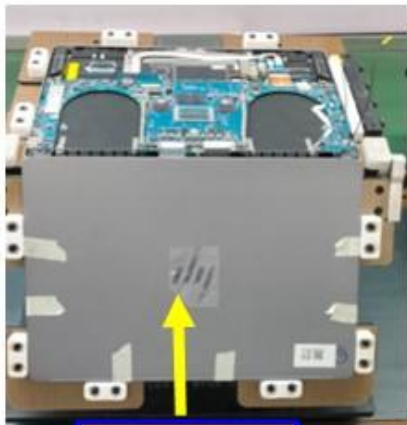
治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
拆机棒	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble LCM

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 9(1/1)
编辑日期: 2024/11/06



Hinge Up

步骤:

-  1. Open the 120-degree Hinge screws *6, 3 on each side
-  Torque value: 2.0 ± 0.2kgf.cm
-  Make sure the screws do not slip
-  2. Take out the Hinge UP



图二



图三

注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子#1	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作 业 指 导 书

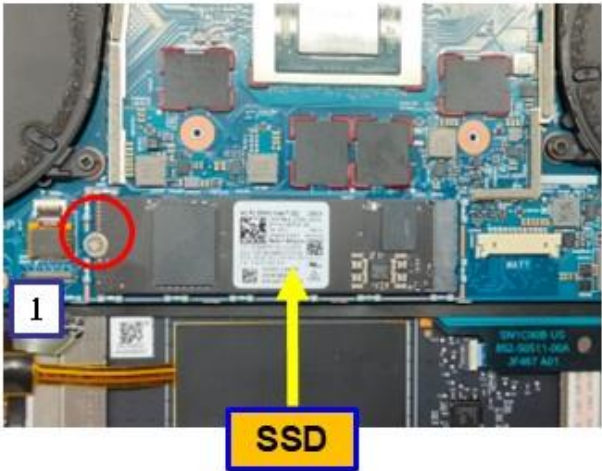
Sub-assembly name :
作 业 名 称 : Disassemble SSD

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 10(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove SSD screws *1
 ◆ Torsion value: 1.5 ± 0.2kgf.cm
 ◆ Make sure the screws do not slip
-  2. Take out the SSD



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子#1	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

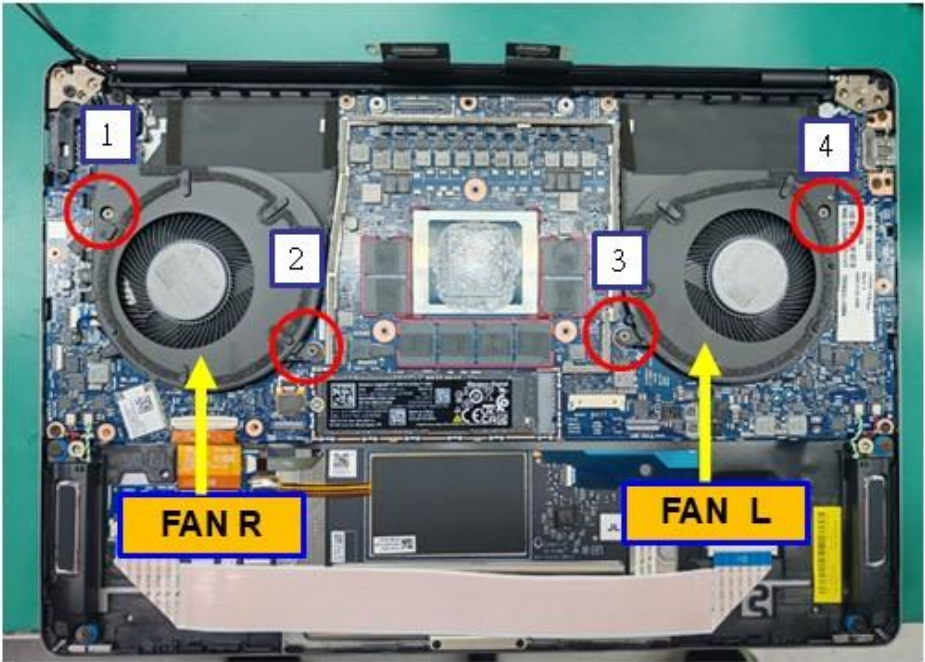
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble FAN

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 11(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove Fan screws *4
◆ Torsion value: 1.5 ± 0.2kgf.cm
◆ Make sure the screws do not slip
-  2. Remove the FAN CNTR , Take out FAN*2



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子#1	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

Sub-assembly name :

Disassembly SOP

站 别: 12(1/1)

作业名称 : Disassemble FFC

Ver. : 1.00 编辑日期: 2024/11/06

步骤:

1. Remove Finger & KB Transfer FFC (Figure 1)
2. Remove Click PAD& NFC FFC (Figure 2)
3. Remove KB backlight &MB Transfer FPC (Figure 3)

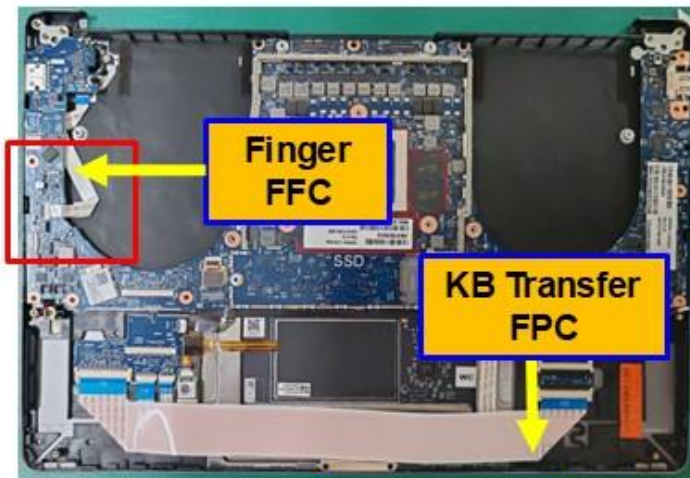


Figure 1

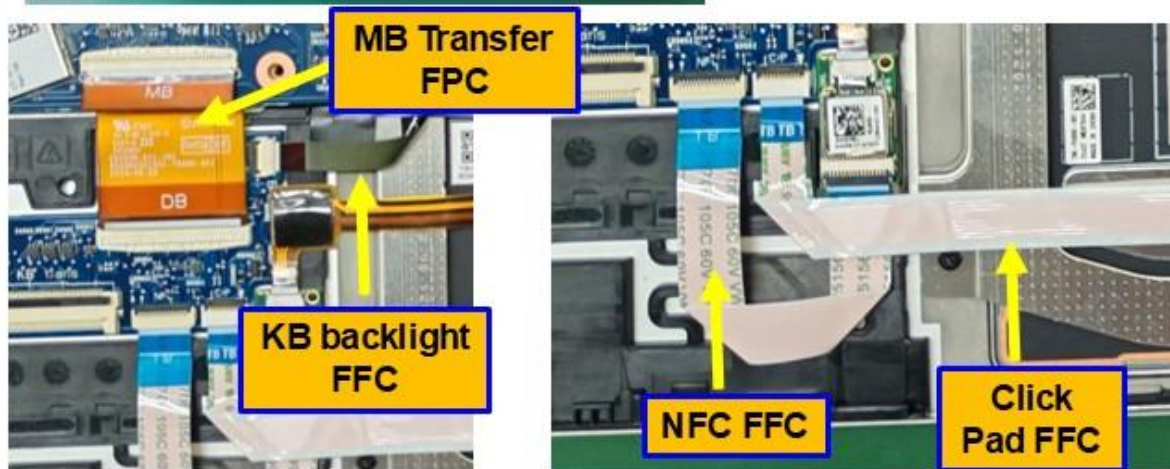


Figure 3

Figure 2

注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作 业 指 导 书

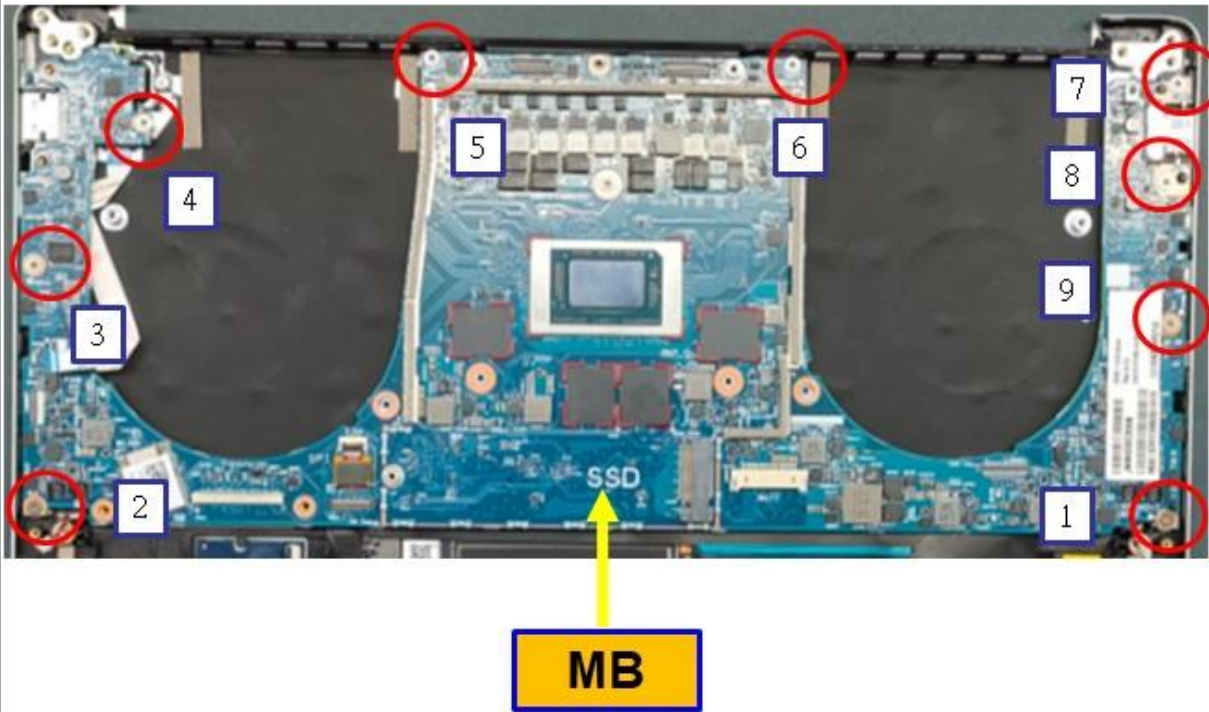
Sub-assembly name :
作 业 名 称 : Disassemble MB

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 13(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove MB screw *9 and take out MB
- ◆ Torsion value: 1.5 ± 0.2kgf.cm
- ◆ Make sure the screws do not slip



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
电动起子#1	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

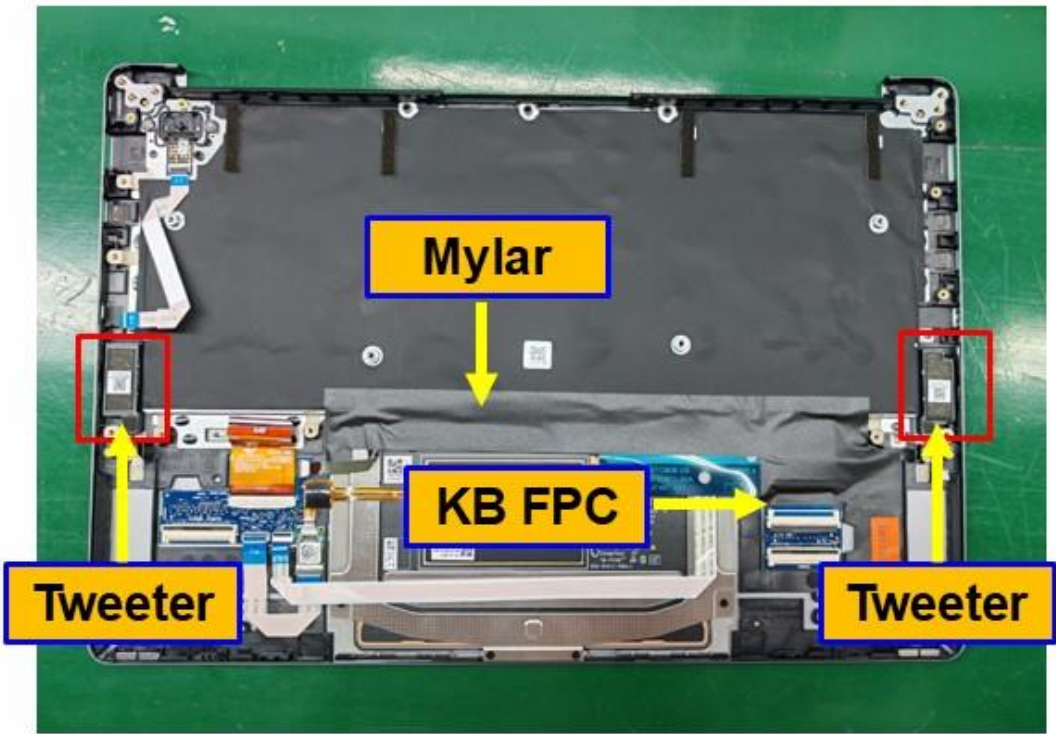
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble Tweeter

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 14(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove the Tweeter*2
-  2. Remove the Mylar and KB FPC



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
									
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

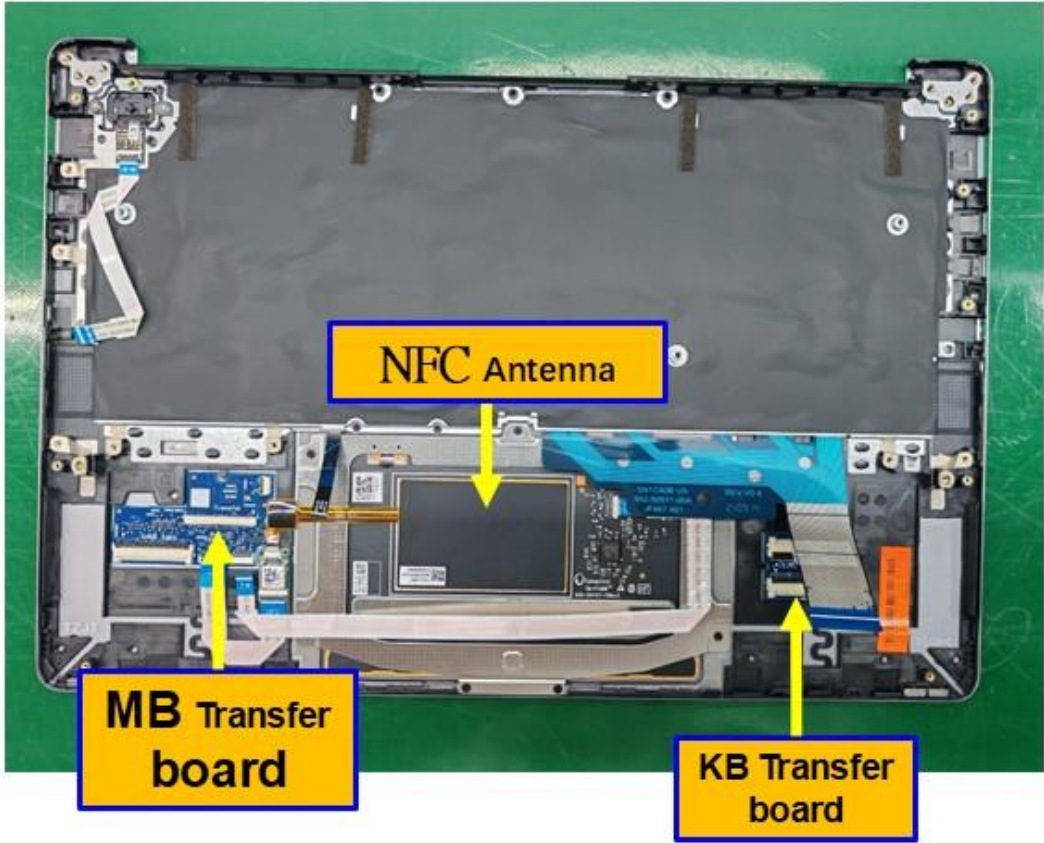
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble KB&MB HUB Board

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 15(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove KB & MB Transfer board
-  2. Remove NFC Antenna Module



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
									
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

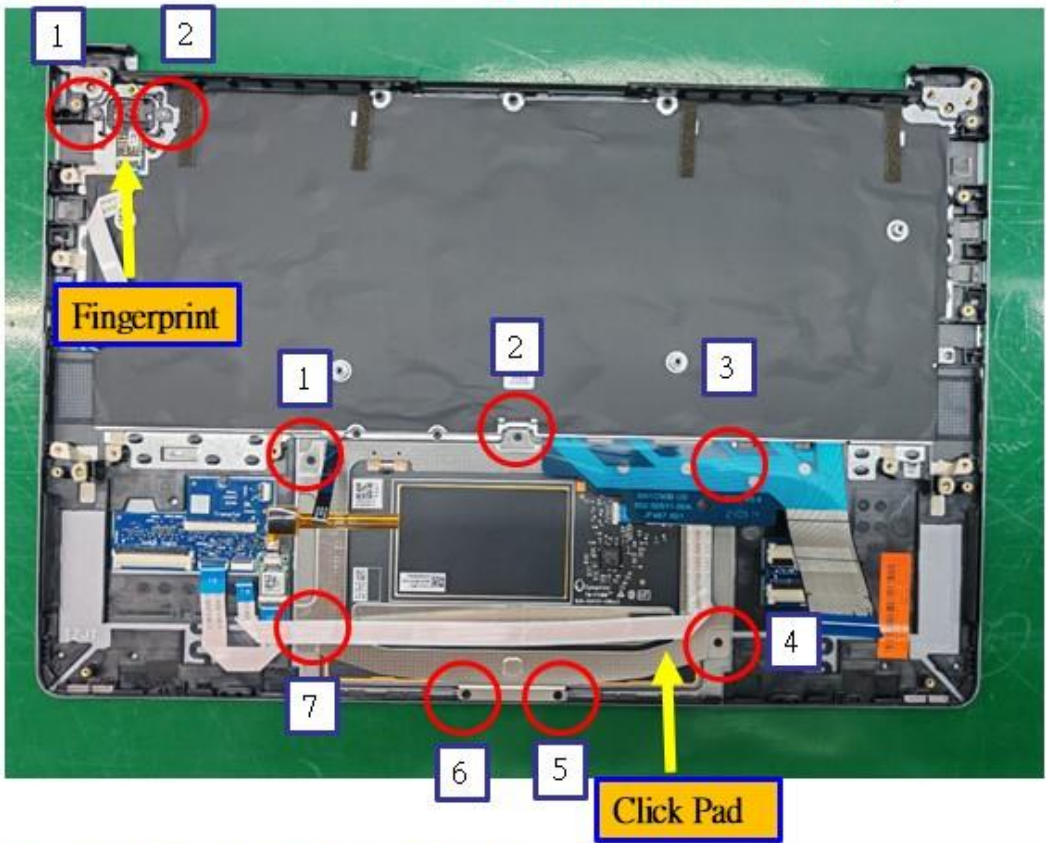
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble Fingerprint & Click Pad

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 16(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove Finger screw *2 and remove Fingerprint Module
- ❖ Torque value: 0.5~ 0.7Kgf.cm
- ❖ Make sure the screws do not slip
-  2. Remove CP screw *7 and take out the Click Pad
- ❖ Torque value: 1.0+/-2Kgf.cm
- ❖ Make sure the screws do not slip



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
									
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

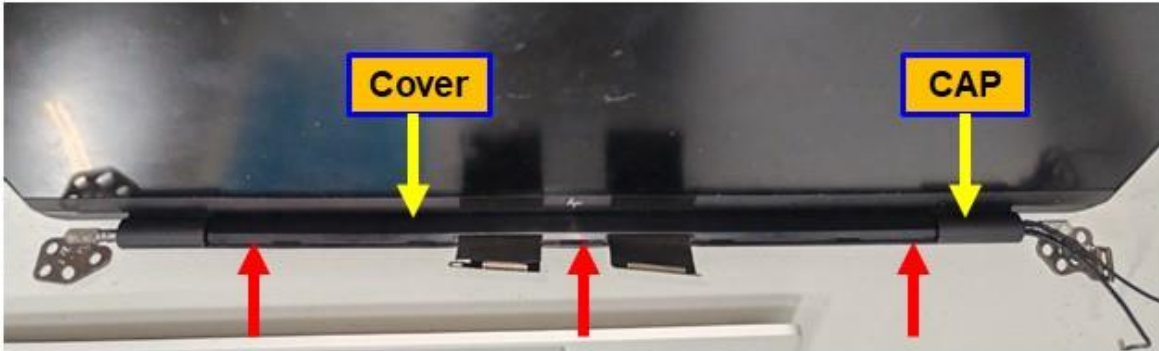
Sub-assembly name :
作业名称 : Disassemble Hinge Cover & Cap

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 17(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove Hinge Cover & Cap
- ❖ Disassemble by applying external forces from the bottom up



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
拆机棒	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

作业指导书

重点站

Sub-assembly name :

Disassembly SOP

站 别: 18(1/1)

作业名称 : Disassemble A Bonding

Ver. : 1.00 编辑日期: 2024/11/06

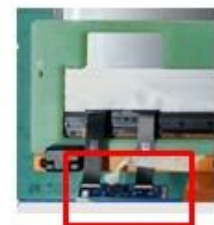
For OLED Touch

步骤:

1. Put the LCM module on the glass face and put it in the oven
 - ❖ Oven temperature: 80+/-5°
 - ❖ Heating time: 5+/-1
2. Remove the panel , Remove touch board
 - ❖ Be careful not to scratch the camera



LCD



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
Hinge up加热治具 拆棒	1 2								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

EL-M
Temj

last t

作业指导书



Sub-assembly name :

Disassembly SOP

站 别: 19(1/1)

作业名称 : Disassemble B Bonding

Ver. : 1.00 编辑日期: 2024/11/06

For AG Non-Touch

步骤:

-  1. Remove Bezel Trim Mylar*2 (Figure 1)
-  2. Use tweezers to slowly pull out the ground side easy drawing glue (Figure 2)
❖ Slightly angled, slowly pulling out
-  3. Remove the LG Mylar (Figure 3)
-  4. Use tweezers to slowly pull out the left and right side of the easy to pull glue from the ground side gap Out (Figure 4)
❖ Pull out slowly

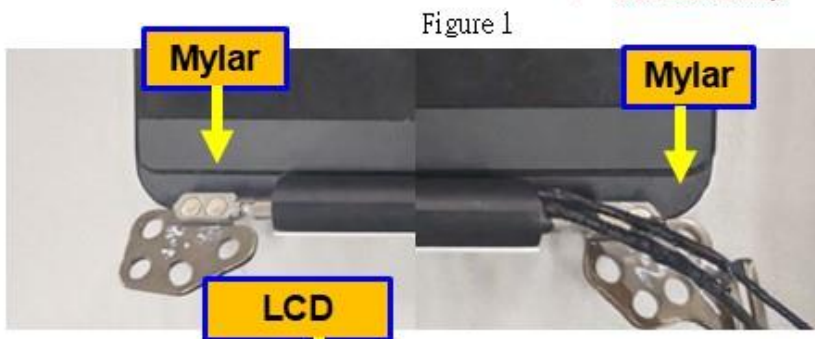


Figure 1



Figure 2



Figure 3

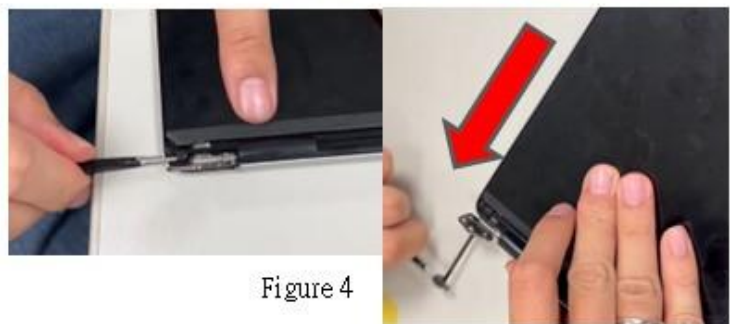


Figure 4

注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
镊子	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作业指导书



Sub-assembly name :

Disassembly SOP

站 别: 20(1/1)

作 业 名 称 : Disassemble B Bonding

Ver. : 1.00 编辑日期: 2024/11/06

步骤:

For AG Non-Touch

1. After the easy stretch glue breaks at the corner of the sky side, push the ground side bezel hook with the cable rod back and tilt, then pull the EDP FPC out from under the bezel (Figure 1).
 2. Place the hinge up on the heating fixture to heat up, open the panel for about 30°~40°, pull the easy-to-pull glue handle from the back of the panel with tweezers, and pull the left easy-to-pull glue at the parallel height of the handle to the left (synchronize on the right side), the force and speed should not be too big and too fast (FIG. 2).
- ❖ Oven temperature :80+/-5°
 - ❖ Heating time :5+/-1 min

Figure 1



Figure 2

注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
镊子 拆机棒塑胶	1 1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

EL-M
Temj

last t

作业指导书



Sub-assembly name :

Disassembly SOP

站 别: 21(1/1)

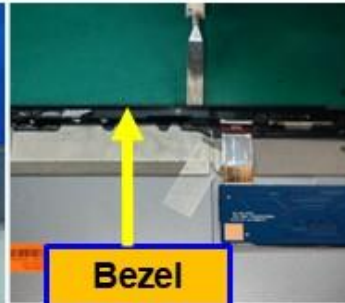
作 业 名 称 : Disassemble A B Bonding

Ver. : 1.00 编辑日期: 2024/11/06

步骤:

For AG Non-Touch

1. After the left and right sides of the skylight are completely extracted, the hinge up is put back into the heating fixture to heat for 5 minutes. The Panel can be slowly opened to 90° at the second position of the camera
 - ❖ Open slowly from the bottom up
2. Reheat and remove Bezel using a disengaging rod
 - ❖ Oven temperature :80+/-5°
 - ❖ Heating time :5+/-1 min



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
拆机棒 Hinge up加热治具	1 1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

EL-M
Temj

last t

作业指导书

Sub-assembly name :

Disassembly SOP

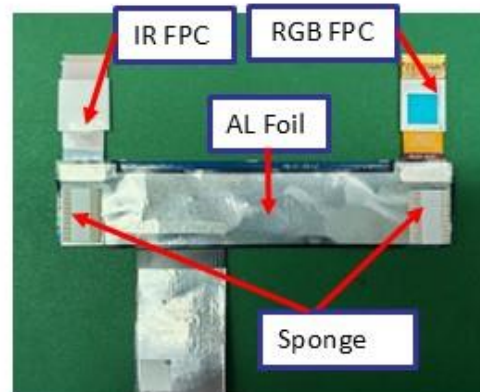
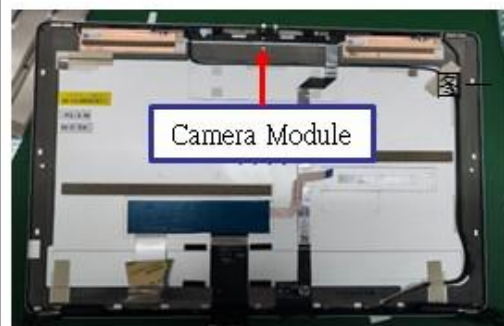
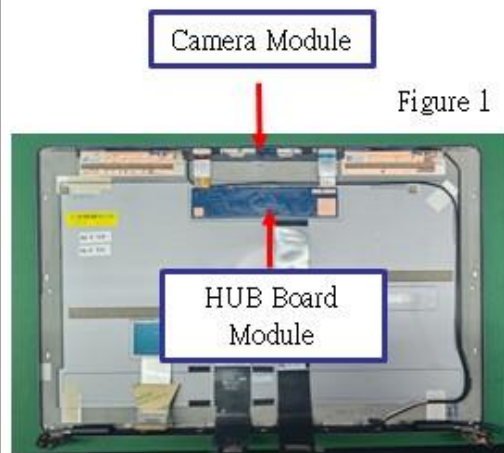
站 别: 22(1/1)

作 业 名 称 : Disassemble Camera & HUB Module

Ver. : 1.00 编辑日期: 2024/11/06

步骤:

1. First remove the IR RGB CNTR at the Camera end, then remove the Camera & Hub module & MIC Rubber (FIG. 1)
❖ Note that the disassembly Camera should not be seriously deformed, and the shielding area should be taken after disassembly
2. Remove Hub Board Mylar, Gasket (Figure 2)
3. Remove the IR RGB Camera FPC at the Hub Board end (Figure 2)
4. Eviee only needs to remove the Camera Module & FPC (Figure 3)



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
镊子	1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作业指导书

Sub-assembly name :

Disassembly SOP

站 别: 23(1/1)

作 业 名 称 : Disassemble PMIC Module

Ver. : 1.00 编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove the PMIC module (Figure 1)
-  2. Remove the PMIC Mylar and Sponge (Figure 2)
-  3. Remove the Touch FFC & EDP FFC & PMIC FPC (Figure 2)



Figure 1

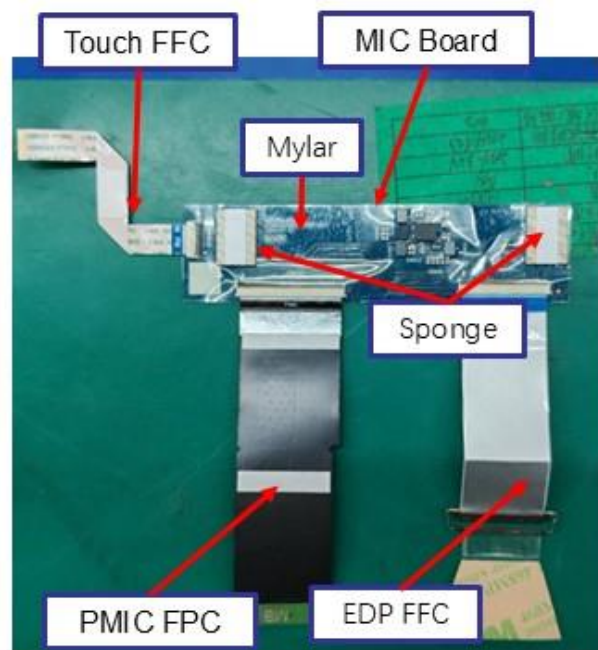


Figure 2

注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
									
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

编号：3QBMDAP001-F003 版本：4 机密等级：一般 使用形式：纸质档 保存期限：最新版本 销毁方式：撕毁

作 业 指 导 书

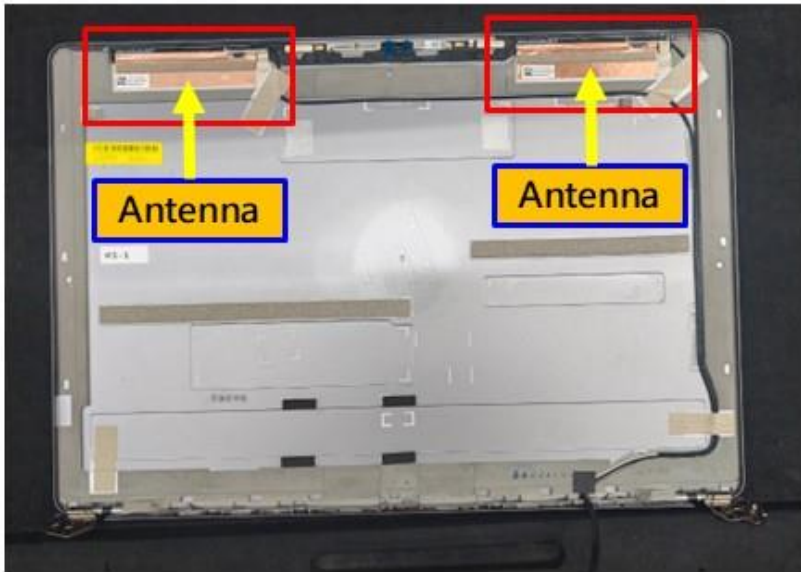
Sub-assembly name :
作 业 名 称 : Disassemble Antenna

Disassembly SOP
Ver. : 1.00

站 别: 24(1/1)
编辑日期: 2024/11/06

步骤:

-  1. Remove the left and right Antenna and gasket*3



注意事项：如有异常，请立即通知领班或助理。

治具清单(治具规格)	数量	符号标识							
镊子 拆机棒	1 1								
		安全	质量	指令	工具	耳听	观察	手动	静电

